

COMPANY RESEARCH AND ANALYSIS REPORT

|| 企業調査レポート ||

フェローテックホールディングス

6890 東証JASDAQ

企業情報はこちら >>>

2022 年 1 月 18 日 (火)

執筆：客員アナリスト

寺島 昇

FISCO Ltd. Analyst **Noboru Terashima**



FISCO Ltd.

<https://www.fisco.co.jp>

フェローテックホールディングス
6890 東証 JASDAQ

2022 年 1 月 18 日 (火)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

目次

■ 要約	01
1. 2022 年 3 月期第 2 四半期の業績概要	01
2. 2022 年 3 月期の業績見通し	01
3. 中期経営計画は前倒し達成の可能性大	02
■ 会社概要	03
1. 会社概要	03
2. 事業セグメント	03
3. 特色、強み	03
■ 業績動向	04
1. 2022 年 3 月期第 2 四半期の業績概要	04
2. セグメント別概況	06
3. 主な設備投資	07
■ 今後の見通し	08
1. 2022 年 3 月期業績見通し	08
2. 主要製品の現況と見通し	08
3. 公募増資と資金使途	09
■ 中期経営計画の進捗	09
■ 株主還元策	10

フェローテックホールディングス
6890 東証 JASDAQ

2022 年 1 月 18 日 (火)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

要約

2022 年 3 月期第 2 四半期の売上高・営業利益はいずれも第 2 四半期として過去最高業績を更新

フェローテックホールディングス <6890> の主力事業は、真空シール、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC (化学蒸着法炭化ケイ素) 製品、磁性流体、サーモモジュールなどの様々な製品・装置・部品・素材等の製造である。加えて、半導体製造装置メーカー向けに各種部品等の洗浄サービスやシリコンウエーハの研磨なども行う企業である。

1. 2022 年 3 月期第 2 四半期の業績概要

2022 年 3 月期第 2 四半期決算は、売上高が前年同期比 43.8% 増の 59,826 百万円、営業利益が同 174.3% 増の 10,733 百万円、経常利益が同 342.3% 増の 12,493 百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は 17,268 百万円(前年同期は 70 百万円の利益)となり、売上高及び営業利益はいずれも第 2 四半期としては過去最高となった。事業別では、世界的な半導体不足を背景とした半導体製造装置メーカー及びデバイスメーカーからの旺盛な需要に支えられて、半導体等装置関連の売上高は 35,895 百万円(前年同期比 24.7% 増)、セグメント利益は 7,104 百万円(同 226.3% 増)となった。特にシリコンパーツの伸びが著しかった。また電子デバイスでも、パワー半導体基板が大きく寄与して売上高は 12,213 百万円(同 71.6% 増)、セグメント利益は 3,052 百万円(同 63.4% 増)となった。さらに営業外において、為替差益 1,503 百万円の計上(前年同期は 1,187 百万円の差損)があり、経常利益の伸びはさらに大きくなった。特別損益では、韓国子会社である Ferrotec Advanced Material Korea Corporation (以下、FTAK) の事業撤退損を特別損失として 927 百万円計上した一方で、ウエーハ事業子会社(持分法)の第三者割当増資(33 億円)による持分変動利益 9,327 百万円を特別利益として計上したことなどから、親会社株主に帰属する四半期純利益は大幅増益となった。

2. 2022 年 3 月期の業績見通し

2022 年 3 月期通期の業績は、売上高 125,000 百万円(前期比 36.9% 増)、営業利益 22,500 百万円(同 133.4% 増)、経常利益 23,500 百万円(同 185.6% 増)、親会社株主に帰属する当期純利益 23,500 百万円(同 183.8% 増)と予想している。好調な上期決算を受けて、期初予想(売上高 105,000 百万円、営業利益 15,000 百万円)から大幅に上方修正された。下期に入っても、半導体業界を取り巻く環境に大きな変化はなく、同社製品に対する需要も引き続き強含みで推移すると予想され、この予想が達成される可能性は高いだろう。むしろ、さらなる上積みがあるのかが焦点になると思われる。通期での設備投資額は 32,000 百万円(前期は 14,297 百万円)、減価償却費は 8,000 百万円(同 9,155 百万円)と計画している。

要約

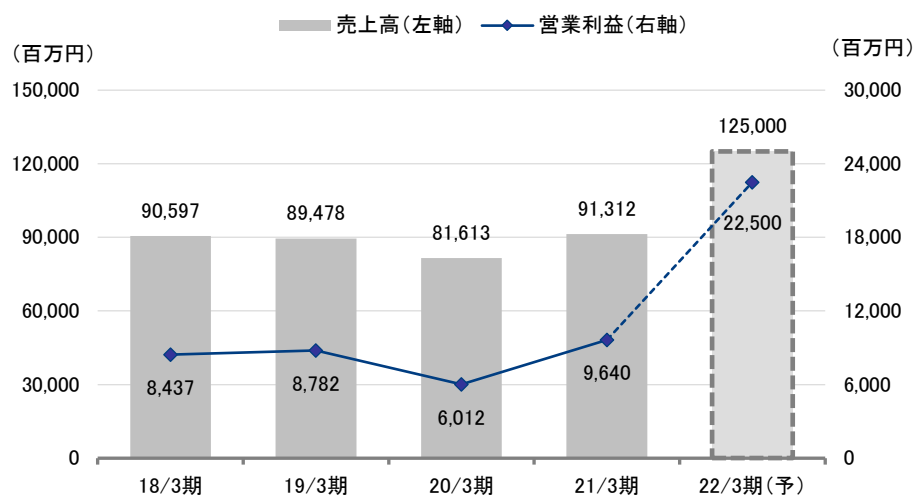
3. 中期経営計画は前倒し達成の可能性大

同社は、2024 年 3 月期を最終年度とする新しい中期経営計画を発表している。この計画の定量的目標として、2023 年 3 月期に売上高 1,250 億円、営業利益 190 億円（営業利益率 15.2%）2024 年 3 月期に売上高 1,500 億円、営業利益 250 億円（同率 16.7%）、親会社株主に帰属する当期純利益 150 億円（売上高比率 10.0%）、ROE15.0%、ROIC8.0%、自己資本比率 40.0% 超としている。しかし既に 2022 年 3 月期の予想を売上高 1,250 億円、営業利益 225 億円としていることから、この目標が 1 年前倒しで達成される可能性が高い。現時点での目標値に変更はないが、来春の決算発表時には目標値の変更あるいは新計画の発表が行われると思われる。

Key Points

- ・石英、セラミックス等の無機系製品の手主メーカー。半導体業界向けが多い
- ・2022 年 3 月期第 2 四半期は予想を大幅に上回って着地。通期予想も上方修正
- ・中期経営計画目標値を 1 年前倒しで達成の可能性大

業績推移



出所：決算短信よりフィスコ作成

会社概要

主要顧客は大手半導体デバイス及び同製造装置メーカー

1. 会社概要

同社は 2021 年 9 月末時点で傘下に連結子会社 55 社、持分法適用子会社 9 社を擁する純粋持株会社で、グループ従業員数は 8,412 人となっている。元々は 1980 年に米国 Ferrofluidics Corporation（現 Ferrotec (USA) Corporation）の日本法人「日本フェローフルイデックス株式会社」として設立されたが、その後、親会社から分離独立し独自路線を歩んでいる。

現在の主力事業は、真空シール、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC 製品、磁性流体、サーモモジュールなど主に無機材料を使った様々な製品・装置・部品・素材等の製造である。加えて、半導体製造装置メーカー向けに各種部品等の洗浄や受託加工・組立サービスなどの事業も行っている。

2. 事業セグメント

前述のように同社は多くの製品を自社開発・製造すると同時に M&A によって多くの企業を子会社化してきたことから、事業内容は多岐にわたっている。事業セグメントは、半導体等装置関連（2021 年 3 月期売上比 66.4%）、電子デバイス（同 18.9%）、その他（同 14.6%）の 3 つに分けられており、それぞれサブセグメントが置かれている。

3. 特色、強み

(1) 無機系素材のパイオニア

同社は石英、シリコン、窒化ケイ素、シリコンカーバイド（SiC）など幅広い無機系素材の生成・加工などに長年携わってきた。そのため、同社内にはこれらの素材に関する多くのノウハウ（素材の性質、生成方法、加工方法等）が蓄積されており、これが同社の特色かつ強みと言えるだろう。

(2) 製造装置も手掛ける

同社は、単に素材だけでなく各種の製造装置も手掛けており、製造装置に関するノウハウも持っている。そのため顧客に対し、素材・加工部品・最終製品・製造装置など様々な提案（ソリューションの提供）を行うことができる。

(3) ワンストップソリューションが可能

同社は、半導体製造装置内の部品の洗浄（取り外し・洗浄・据付）や製造装置の組立等のサービス事業も展開している。顧客にとっては素材の供給、部品加工、装置類の組立、部品洗浄などをワンストップで外注化（アウトソーシング）することが可能であり、これも同社の強みと言える。

(4) 大手顧客との信頼関係

同社の主要製品は、主に半導体製造装置向け及び半導体製造プロセスで使われるため、同社の主要顧客は世界でトップクラスの半導体製造装置メーカーも多い。同社はこれらの大手半導体製造装置メーカーに長年にわたる製品や部品を供給しており、これら顧客との深い信頼関係も同社の財産であり強みとなっている。

業績動向

2022 年 3 月期第 2 四半期は世界的な半導体需要増を背景に大幅増益

1. 2022 年 3 月期第 2 四半期の業績概要

(1) 損益状況

2022 年 3 月期第 2 四半期決算は、売上高が前年同期比 43.8% 増の 59,826 百万円、営業利益が同 174.3% 増の 10,733 百万円、経常利益が同 342.3% 増の 12,493 百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は 17,268 百万円（前年同期は 70 百万円の利益）となり、売上高及び営業利益はいずれも第 2 四半期としては過去最高となった。

新型コロナウイルス感染症の拡大によるテレワーク需要の高まりや 5G 関連の投資増大による世界的な半導体不足を背景に、半導体デバイスメーカー及び同製造装置メーカーからの需要が高まったことに加え、過去の大型設備投資により同社の生産能力もアップしたことで、売上高は前年同期比で大幅増となった。事業別でも、半導体等装置関連、電子デバイスともに増収となった。ほとんどの製品（サブセグメント）で増収となったが、特にシリコンパーツとパワー半導体基板の伸びが著しかった。

大幅増収に加え、ウエーハ事業を切り離したことにより全体の売上総利益率は 37.2%（前年同期は 33.9%）と改善し、売上総利益額は 22,238 百万円（前年同期比 57.7% 増）となった。その一方で、販管費は 11,505 百万円（同 13.0% 増）にとどまったことから営業利益は大幅増益となった。さらに営業外において、為替差益 1,503 百万円の計上（前年同期は 1,187 百万円の差損）があり、経常利益の伸びはさらに大きくなった。特別損益では、韓国子会社 FTAK の事業撤退損を特別損失として 927 百万円計上した一方で、ウエーハ事業子会社（持分法）の第三者割当増資（33 億円）による持分変動利益 9,327 百万円を特別利益として計上したことなどから、親会社株主に帰属する四半期純利益は大幅増益となった。

フェローテックホールディングス

6890 東証 JASDAQ

2022 年 1 月 18 日 (火)

<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

業績動向

2022 年 3 月期第 2 四半期業績

(単位：百万円)

	21/3 期 2Q		22/3 期 2Q		前年同期比	
	実績	売上比	実績	売上比	増減額	増減率
売上高	41,595	100.0%	59,826	100.0%	18,231	43.8%
売上総利益	14,098	33.9%	22,238	37.2%	8,140	57.7%
販管費	10,185	24.5%	11,505	19.2%	1,319	13.0%
営業利益	3,913	9.4%	10,733	17.9%	6,820	174.3%
経常利益	2,824	6.8%	12,493	20.9%	9,668	342.3%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	70	0.2%	17,268	28.9%	17,197	24,252.0%
設備投資額	10,136	24.4%	13,899	23.2%	3,763	37.1%
減価償却費	4,605	11.1%	3,771	6.3%	-834	-18.1%

出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

設備投資により有形固定資産が増加

(2) 財務状況

2022 年 3 月期第 2 四半期末の財務状況は、流動資産が 116,254 百万円(前期末比 28,177 百万円増)となった。主に現金及び預金の増加 18,007 百万円、受取手形、売掛金及び契約債権(2022 年 3 月期より科目名称変更)の増加 5,553 百万円、たな卸資産の増加 4,672 百万円による。現金及び預金が増大幅となったのは、主に中国子会社の第三者割当増資によるものである。固定資産は前期末比で 22,039 百万円増加し 111,151 百万円となった。主に設備投資(中国の再生ウエーハ、銀川シリコンパーツ・坩堝事業、東台石英の子会社における設備投資など)による有形固定資産の増加 13,652 百万円、投資その他資産の増加 8,404 百万円(主にウエーハ事業会社の第三者割当増資による持分変動利益計上とともに関係会社株式残高増など)による。その結果、資産合計は 227,405 百万円(同 50,216 百万円増)となった。

負債合計は、102,525 百万円(同 3,575 百万円増)となった。要因として、電子記録債務を含む支払手形及び買掛金の増加 5,267 百万円、1 年内返済予定の長期借入金を含む短期借入金の減少 263 百万円、社債の減少 1,434 百万円、新株予約権付社債の減少 1,448 百万円、長期借入金の減少 1,120 百万円等による。また純資産合計は、124,880 百万円(同 46,640 百万円増)となった。中国子会社の第三者割当増資による資本剰余金の増加 8,945 百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加 16,598 百万円、円安進行に伴う為替換算調整勘定の増加 4,324 百万円、中国子会社への第三者割当増資による非支配株主持分の増加 15,759 百万円等によるものである。この結果、2022 年 3 月期第 2 四半期末の自己資本比率は 43.1%(前期末は 37.9%)と改善した。

(3) 子会社の資金調達と上場予定

同社は、中国において様々な子会社を設立しており、主要な子会社の 2022 年 3 月期第 2 四半期末(2021 年 9 月末)までの資金調達状況(それに伴う同社持分の出資比率)は、半導体シリコンウエーハを扱う持分法適用会社では 553 億円(期初で 29.5%→第 2 四半期末で 23.0%)、SiC 単結晶インゴット・ウエーハを扱う子会社では 32 億円(同 38.98%→29.5%)、連結子会社では、石英坩堝・シリコンパーツを扱う連結子会社では 91 億円(同 90.0%→66.7%)、パワー半導体基板製造子会社では 83 億円(同 88.9%→66.7%)、精密部品・装置部品再生洗浄子会社は同 67.7%→67.5%、半導体再生ウエーハ子会社は 44 億円(同 31.8%→22.5%)。グループ会社が現物出資後、出資比率は 41.3%の予定(連結前提))となっている。また、これら子会社のうち、石英坩堝・シリコンパーツ子会社、パワー半導体基板製造子会社、精密部品・装置部品再生洗浄子会社は、中国の株式市場に上場を計画している。

本資料のご利用については、必ず巻末の重要事項(ディスクレマー)をお読みください。

Important disclosures and disclaimers appear at the back of this document.

フェローテックホールディングス

6890 東証 JASDAQ

2022 年 1 月 18 日 (火)

<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

業績動向

主要子会社の資金調達と持分比率

	中国子会社	外部調達額 (22/3 期 2Q 末)	出資比率の変化	
			21/3 期末	22/3 期 2Q 末
持分法適用会社	半導体シリコンウエーハ	553 億円	29.5%	→ 23.0%
	SiC 単結晶インゴット・ウエーハ	32 億円	38.98%	→ 29.5%
連結子会社	石英坩堝・シリコンパーツ	91 億円	90.0%	→ 66.7%
	パワー半導体基板製造	83 億円	88.9%	→ 66.7%
	精密部品・装置部品再生洗浄	-	67.7%	→ 67.5%
	半導体再生ウエーハ	44 億円※	31.8%	→ 22.5% ※

※グループ会社が現物出資後、出資比率は 41.3% の予定（連結前提）。

出所：中期経営計画進捗報告よりフィスコ作成

2. セグメント別概況

セグメント別では、主力の半導体等装置関連は売上高 35,895 百万円（前年同期比 24.7% 増）、営業利益 7,104 百万円（同 226.3% 増）、電子デバイスは売上高は 12,213 百万円（同 71.6% 増）、営業利益 3,052 百万円（同 63.4% 増）、その他は売上高 11,717 百万円（同 105.8% 増）、営業利益 700 百万円（同 103.1% 増）となった。

セグメント別売上高・営業利益

（単位：百万円）

	21/3 期 2Q		22/3 期 2Q		前年同期比	
	実績	売上比	実績	売上比	増減額	増減率
売上高	41,595	100.0%	59,826	100.0%	18,231	43.8%
半導体等装置関連	28,784	69.2%	35,895	60.0%	7,110	24.7%
真空シール	4,377	10.5%	6,018	10.1%	1,641	37.5%
石英製品	7,713	18.5%	10,132	16.9%	2,419	31.4%
シリコンパーツ	1,411	3.4%	2,778	4.6%	1,367	96.9%
セラミックス	5,681	13.7%	8,422	14.1%	2,741	48.2%
CVD-SiC	1,143	2.7%	1,389	2.3%	246	21.5%
EB ガン・LED 蒸着装置	1,450	3.5%	2,056	3.4%	606	41.8%
ウエーハ加工	3,102	7.5%	43	0.1%	-3,059	-98.8%
装置部品洗浄	3,458	8.3%	4,483	7.5%	1,025	29.6%
石英坩堝	450	1.1%	574	1.0%	124	27.7%
電子デバイス	7,116	17.1%	12,213	20.4%	5,097	71.6%
サーモモジュール	5,501	13.2%	8,424	14.1%	2,923	53.1%
パワー半導体基板	1,313	3.2%	3,349	5.6%	2,036	155.1%
磁性流体・その他	302	0.7%	440	0.7%	138	45.8%
その他	5,693	13.7%	11,717	19.6%	6,023	105.8%
営業利益	3,913	9.4%	10,733	17.9%	6,820	174.3%
半導体等装置関連	2,177	7.6%	7,104	19.8%	4,926	226.3%
電子デバイス	1,867	26.2%	3,052	25.0%	1,184	63.4%
その他	344	6.1%	700	6.0%	355	103.1%
調整額	-476	-	-123	-	353	-

出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

フェローテックホールディングス

6890 東証 JASDAQ

2022 年 1 月 18 日 (火)

<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

業績動向

(1) 真空シール

売上高は 6,018 百万円（前年同期比 37.5% 増）となった。半導体製造装置向けの需要増加に加え、半導体製造装置メーカーからの金属受託加工が拡大し、売上が増加した。

(2) 石英製品

売上高は 10,132 百万円（同 31.4% 増）となった。需要の拡大に加えて常山工場・東台工場の稼働により売上が増加した。

(3) シリコンパーツ

売上高は 2,778 百万円（96.9% 増）となった。需要拡大に対して銀川工場の生産能力が拡大したことで増収となった。需要の要因は、半導体業界全体が活況であったことのほか、米国系大手半導体製造装置メーカーがそれまで内製化していた部品を同社製品に切り替えたことも、売上高を押し上げる要因となった。同社製品が高く評価されてきた証と言える。

(4) セラミックス

売上高は 8,422 百万円（同 48.2% 増）となった。半導体向け製品及びプローブカード向け製品の需要が増加し、大幅増収となった。

(5) ウェーハ加工と装置部品洗浄

半導体ウェーハ加工の売上高は、関連する子会社が連結対象から外れたため、売上高は大幅に減少した。その一方で、装置部品洗浄は中国での半導体メーカーや FPD（フラットパネルディスプレイ）メーカーの需要が堅調に推移し、売上高は 4,483 百万円（同 29.6% 増）となった。

(6) サーモモジュール

売上高は 8,424 百万円（同 53.1% 増）となった。5G 通信機器向け及び PCR 検査機など医療分野向けが堅調であることに加え、常山工場の生産能力増強が寄与、家電民生品向け需要が拡大した。

(7) パワー半導体基板

売上高は 3,349 百万円（同 155.1% 増）となった。DCB（Direct Copper Bonding）基板の需要が拡大したことに加えて、東台工場の生産能力増強により売上は拡大した。また自動車向けの AMB（Active Metal Brazing）基板も需要が堅調に推移したことに加え、生産能力の拡大が貢献した。

3. 主な設備投資

設備投資額（キャッシュ・フローベース）は、13,899 百万円（前年同期は 10,136 百万円）であった。主に中国の再生ウェーハ、銀川シリコンパーツ / 坩堝事業、東台石英の子会社における設備投資に向けた投資である。減価償却費は 3,771 百万円（同 4,605 百万円）となった。

フェローテックホールディングス
6890 東証 JASDAQ

2022 年 1 月 18 日 (火)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

■ 今後の見通し

2022 年 3 月期営業利益は上方修正され 225 億円予想。 半導体等装置関連、電子デバイスともに堅調

1. 2022 年 3 月期業績見通し

2022 年 3 月期通期の業績は、売上高 125,000 百万円 (前期比 36.9% 増)、営業利益 22,500 百万円 (同 133.4% 増)、経常利益 23,500 百万円 (同 185.6% 増)、親会社株主に帰属する当期純利益 23,500 百万円 (同 183.8% 増) 予想となっている。期初予想 (売上高 105,000 百万円、営業利益 15,000 百万円) から大幅な上方修正となった。下期に入っても、半導体業界を取り巻く環境に大きな変化はなく、同社製品に対する需要も引き続き強含みで推移すると予想され、この予想が達成される可能性は高いだろう。むしろ、さらなる上積みがあるのかが焦点になると思われる。通期での設備投資額は 32,000 百万円 (前期は 14,297 百万円)、減価償却費は 8,000 百万円 (同 9,155 百万円) と計画されている。

セグメント別売上高は、半導体等装置関連 76,379 百万円 (同 25.9% 増)、電子デバイス 26,094 百万円 (同 51.1% 増)、その他 22,528 百万円 (同 68.5% 増) を予想している。

2. 主要製品の現況と見通し

(1) 真空シール

半導体製造装置向けの真空シールの需要拡大に加え、半導体製造装置向けのチャンバー・ロボット部品等の金属受託加工事業を積極的に拡大しており、売上高は前期比 50.3% 増の 13,218 百万円を予想している。

(2) 半導体マテリアル (石英、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC)

石英製品は半導体関連メーカーからの増産要請が継続、常山工場・東台工場の稼働により売上は伸長する見通しで、売上高は同 18.8% 増の 20,332 百万円を見込む。シリコンパーツは需要拡大が著しく、生産体制を拡充した銀川工場の稼働により、急速に売上が拡大する見通しで売上高は前期比 125.6% 増の 7,278 百万円が見込まれる。セラミックスも半導体関連メーカーの需要拡大が継続、プローブカードメーカー向けも堅調に推移する見込みで、売上高は前期比 43.2% 増の 17,572 百万円と予想している。CVD-SiC も半導体関連メーカーの需要が拡大し、売上高は前期比 34.9% 増の 2,949 百万円予想となっている。

(3) 部品洗浄

売上高は前期比 25.1% 増の 9,483 百万円を見込む。中国における半導体関連の洗浄需要は堅調に拡大する見込みで、これに伴い工場新設やサービス分野の拡大を進めており、売上伸長が継続する見通し。

フェローテックホールディングス

6890 東証 JASDAQ

2022 年 1 月 18 日 (火)

<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

今後の見通し

(4) サーモモジュール

売上高は前期比 31.4% 増の 17,124 百万円の見込み。5G 通信機器向け、医療分野ともに需要は堅調に推移するほか、家電民生品分野の需要も拡大する見通しとなっている。

(5) パワー半導体基板

売上高は前期比 130.6% 増の 8,049 百万円を予想している。DCB 基板の需要拡大が継続しており、売上が増加する見通しである。また、量産体制を構築した AMB 基板の需要も拡大する見込みとなっている。

3. 公募増資と資金使途

旺盛な設備投資を賄うために、同社は一般募集による 4,858,300 株の新株発行（公募増資）を発表した。この新株発行数は、2021 年 10 月 31 日現在の発行済株式数 38,958,486 株 に対して 12.5% に相当する。募集価格は 3,667 円と決定しており、同社の手取概算額は約 190.3 億円となった。発表された使途は、石英事業の生産能力増強（東台工場）に 15 億円、金属加工事業の生産能力増強（常山工場）に 50 億円、セラミック事業の特殊製品開発・量産のためのグリーンフィールド投資（石川第二工場）に 30 億円、サーモモジュール事業の生産能力増強（常山工場）に 33 億円、中国本部棟建設に 45 億円、残りは借入金の返済（社債の償還資金）などに充当することとなっている。

■ 中期経営計画の進捗

中期経営計画は 1 年前倒しで達成の可能性大

(1) 数値目標

同社は、2024 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画を発表している。この中期経営計画の定量的目標は、2023 年 3 月期に売上高 1,250 億円、営業利益 190 億円、営業利益率 15.2%、親会社株主に帰属する当期純利益 110 億円としている。最終年度となる 2024 年 3 月期は売上高 1,500 億円、営業利益 250 億円、営業利益率 16.7%、親会社株主に帰属する当期純利益 150 億円を目標としている。しかし 2022 年 3 月期の予想を売上高 1,250 億円、営業利益 225 億円としていることから、この計画が 1 年前倒しで達成される可能性は高い。同社は、現時点でこの中期経営計画の目標を変更していないが、2022 年 3 月期決算発表時には、目標値の変更あるいは新たな中期経営計画の発表が行われるものと思われる。

2022 年 3 月期予想及び中期経営計画目標数値

(単位：億円)

	22/3 期 予想 (11/12 修正)	23/3 期 計画	24/3 期 計画
売上高	1,250	1,250	1,500
営業利益	225	190	250
営業利益率	18.0%	15.2%	16.7%
親会社株主に帰属する当期純利益	235	110	150

出所：中期経営計画進捗報告よりフィスコ作成

本資料のご利用については、必ず巻末の重要事項（ディスクレーマー）をお読みください。

Important disclosures and disclaimers appear at the back of this document.

フェローテックホールディングス
6890 東証 JASDAQ

2022 年 1 月 18 日 (火)
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>

中期経営計画の進捗

(2) 設備投資

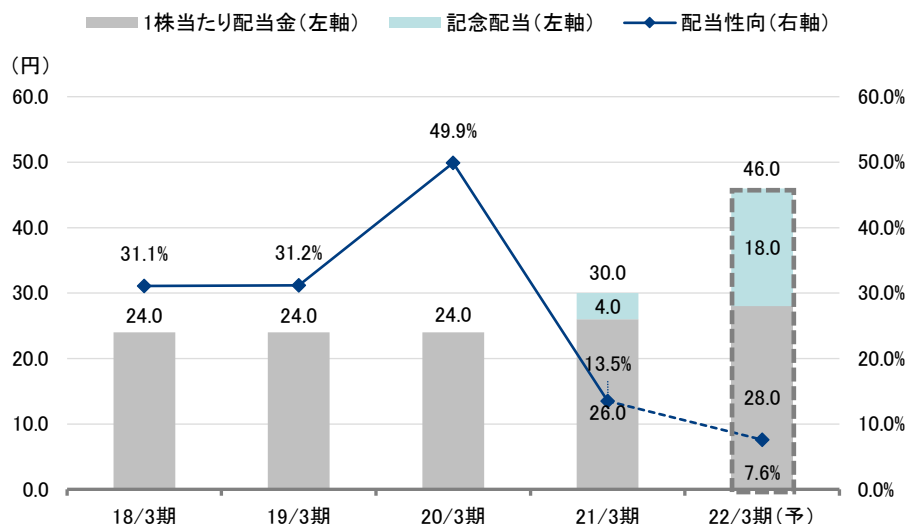
同社は、設備投資計画についても変更なく、2024 年 3 月期までの 3 年間で 950 億円の設備投資を予定している。このうち 550 億円を短期・中期の収益貢献として、半導体分野、電子デバイス等を中心に、市場拡大機会を捉え生産力増強へ積極的に投資を行う計画である。残りの 450 億円は長期的な収益貢献として、1) 半導体分野の製品レンジ拡充、2) EV（電気自動車）・新エネルギー車関連、3) 新たな柱となる事業への投資、を行う計画だ。

株主還元策

当面は積極的な設備投資優先も、将来はさらなる増配に期待

同社は株主還元策として配当を実施している。2019 年 3 月期、2020 年 3 月期と年間 24 円配当を行ったが、2021 年 3 月期は記念配当を含めて 30 円の配当を行った。進行中の 2022 年 3 月期は、好調な業績に伴い年間配当金を 30 円から 46 円（予想配当性向 7.6%）への増配を発表している。同社は「今後は、投資拡大のため配当性向は下がるものの、収益性改善に応じた安定配当による最大限の株主還元を目指す」と述べており、利益水準によってはさらなる増配の可能性もありそうだ。

1株当たり配当金及び配当性向



出所：決算短信よりフィスコ作成

重要事項（ディスクレマー）

株式会社フィスコ（以下「フィスコ」という）は株価情報および指数情報の利用について東京証券取引所・大阪取引所・日本経済新聞社の承諾のもと提供しています。

本レポートは、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行為および行動を勧誘するものではありません。

本レポートはフィスコが信頼できると判断した情報をもとにフィスコが作成・表示したものです。フィスコは本レポートの内容および当該情報の正確性、完全性、的確性、信頼性等について、いかなる保証をするものではありません。

本レポートに掲載されている発行体の有価証券、通貨、商品、有価証券その他の金融商品は、企業の活動内容、経済政策や世界情勢などの影響により、その価値を増大または減少することもあり、価値を失う場合があります。本レポートは将来のいかなる結果をお約束するものでもありません。お客様が本レポートおよび本レポートに記載の情報をいかなる目的で使用する場合においても、お客様の判断と責任において使用するものであり、使用の結果として、お客様になんらかの損害が発生した場合でも、フィスコは、理由のいかんを問わず、いかなる責任も負いません。

本レポートは、対象となる企業の依頼に基づき、企業への電話取材等を通じて当該企業より情報提供を受けて作成されていますが、本レポートに含まれる仮説や結論その他全ての内容はフィスコの分析によるものです。本レポートに記載された内容は、本レポート作成時点におけるものであり、予告なく変更される場合があります。フィスコは本レポートを更新する義務を負いません。

本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はフィスコに帰属し、フィスコに無断で本レポートおよびその複製物を修正・加工、複製、送信、配布等することは強く禁じられています。

フィスコおよび関連会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員は、本レポートに掲載されている金融商品または発行体の証券について、売買等の取引、保有を行っているまたは行う場合があります。

以上の点をご了承の上、ご利用ください。

■お問い合わせ■

〒107-0062 東京都港区南青山 5-13-3

株式会社フィスコ

電話：03-5774-2443（IR コンサルティング事業本部）

メールアドレス：support@fisco.co.jp